



平成31年3月期 第3四半期決算短信(日本基準)(連結)

平成31年2月7日

上場会社名 TOWA株式会社

上場取引所 東

コード番号 6315 URL <http://www.towajapan.co.jp>

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 岡田 博和

問合せ先責任者 (役職名) 経営企画本部長 (氏名) 柴原 信隆

TEL 075 - 692 - 0251

四半期報告書提出予定日 平成31年2月8日

配当支払開始予定日

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成31年3月期第3四半期の連結業績(平成30年4月1日～平成30年12月31日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
31年3月期第3四半期	21,341	5.9	606	81.2	606	81.0	540	75.5
30年3月期第3四半期	22,678	5.3	3,230	1.2	3,190	10.5	2,204	25.7

(注) 包括利益 31年3月期第3四半期 501百万円 (%) 30年3月期第3四半期 3,059百万円 (5.6%)

	1株当たり四半期純利益	潜在株式調整後1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
31年3月期第3四半期	21.62	
30年3月期第3四半期	88.13	

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
31年3月期第3四半期	42,888	27,115	63.0
30年3月期	39,842	27,905	70.0

(参考) 自己資本 31年3月期第3四半期 27,006百万円 30年3月期 27,905百万円

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、平成30年3月期については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値を記載しております。

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
30年3月期		0.00		16.00	16.00
31年3月期		0.00			
31年3月期(予想)				16.00	16.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成31年3月期の連結業績予想(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	28,250	8.9	550	85.1	550	84.5	500	83.5	19.99

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

連結業績予想の修正については、本日(平成31年2月7日)公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 有

新規 1 社 (社名) 東和半導体設備(南通)有限公司、除外 社 (社名) -

(注)詳細は、添付資料P.7「2.四半期連結財務諸表及び主な注記(3)四半期連結財務諸表に関する注記事項(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)」をご覧ください。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無

以外の会計方針の変更 : 無

会計上の見積りの変更 : 無

修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

期末発行済株式数(自己株式を含む)

31年3月期3Q	25,021,832 株	30年3月期	25,021,832 株
----------	--------------	--------	--------------

期末自己株式数

31年3月期3Q	12,450 株	30年3月期	12,266 株
----------	----------	--------	----------

期中平均株式数(四半期累計)

31年3月期3Q	25,009,485 株	30年3月期3Q	25,009,894 株
----------	--------------	----------	--------------

四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
2. 平成30年10月29日に公表いたしました業績予想は、本資料において修正しております。業績予想等に関する詳細は、添付資料P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報(2)連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
3. 四半期決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載しております。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期連結貸借対照表	3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	5
四半期連結損益計算書	
第3四半期連結累計期間	5
四半期連結包括利益計算書	
第3四半期連結累計期間	6
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	7
(継続企業の前提に関する注記)	7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	7
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)	7
(追加情報)	7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善は続くものの、米中貿易戦争による海外需要の減少により、企業への影響が広がる等、先行きに不透明感が増しております。世界経済もまた、米中貿易戦争の深刻化により中国経済が大きく落ち込んでおり、これまで堅調であった米国企業にも影響が出始める等、世界経済全体に減速懸念が強まっております。

半導体業界におきましては、大手スマートフォンメーカーが業績を下方修正する等、買い替えサイクルの長期化によりスマートフォン市場に減速感が見られます。また、需給バランスの悪化により価格の下落が続くメモリーは、価格の底が見えず、半導体メーカー各社は設備投資に踏み切れない状況にあります。さらに、米中貿易戦争の影響により中国での設備投資が急減する等、これまで市場を牽引してきたスマートフォン、メモリー、中国市場の減速を受け、足元の市場環境は大きく悪化しております。

このような状況のもと、当社グループは現在の厳しい市場環境を、「TOWA 10年ビジョン」達成のための、経営基盤のさらなる強化に取り組む時期と前向きに捉え、収益力向上に向けたコスト削減の実施や、台湾及び本社・工場においてプライベートショーを開催し、最新の製造装置やモールドイング工程における新たなコンセプトを提案する等、「世界のモールドプロセスをTOWAへ!!」を目指し、次なる飛躍に向けた取り組みを行いました。

以上の結果、当第3四半期連結累計期間の連結業績は、売上高213億41百万円（前年同期比13億36百万円、5.9%減）、営業利益6億6百万円（前年同期比26億23百万円、81.2%減）、経常利益6億6百万円（前年同期比25億84百万円、81.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益5億40百万円（前年同期比16億63百万円、75.5%減）となりました。

なお、セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

[半導体製造装置事業]

半導体製造装置事業における経営成績は、車載や汎用品向けの金型・装置販売及び、改造・修理、パーツ・中古機販売を行うトータル・ソリューション・サービス（TSS）や、金型加工で培った超精密加工技術を応用展開した受託加工等の新規事業分野は堅調に推移いたしました。スマートフォン需要の減少を受けOSAT（半導体後工程受託生産会社）各社がハイエンドデバイス向けの設備投資を控えたことや、中国国内企業の設備投資需要が急減した結果、売上高192億61百万円（前年同期比23億37百万円、10.8%減）となりました。

収益面では、主力製品のコストダウンを行いました。ハイエンドデバイス向けの高付加価値製品を中心に売上台数が大きく落ち込んだため、営業利益4億50百万円（前年同期比26億49百万円、85.5%減）となりました。

[ファインプラスチック成形品事業]

ファインプラスチック成形品事業における経営成績は、売上高11億76百万円（前年同期比98百万円、9.1%増）、営業利益1億56百万円（前年同期比25百万円、19.4%増）となりました。

[レーザ加工装置事業]

レーザ加工装置事業につきましては、第2四半期連結会計期間よりオムロンレーザーフロント株式会社の株式を取得したため、報告セグメントを追加しております。

レーザ加工装置事業における経営成績は、引き続き車載向けを中心とした電子部品需要の底堅さを背景に、レーザトリマの売上が堅調に推移し、売上高9億3百万円となりました。第2四半期連結会計期間に、オムロンレーザーフロント株式会社の株式取得にともなう、のれんの償却費（56百万円）を計上したため、営業損失0百万円となりました。

(2) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

スマートフォン需要の減少やメモリー価格の下落、米中貿易戦争の深刻化により、顧客の投資計画が軒並み見送られ、当社を取り巻く環境は日に日に悪化しております。想定を超えた落ち込みは底が見えない状況で、第3四半期に続き、第4四半期以降も顧客の需要回復は期待出来ず、売上高が大きく減少する見込みです。厳しい市場環境を受け、グループ一丸となりさらなるコストダウンの実施と販売管理費の削減を行います。売上高の減少に加え、ハイエンドデバイス向け製品の売上台数が大きく下振れし、製品ミックスが悪化すること、また、先行的に手配していたプラットフォーム（顧客毎のカスタマイズ仕様に影響しない標準部分）等が、顧客の投資計画変更にともない社内の規定期間を超過した滞在在庫となり、会計上の評価損が発生することから、利益についても当初予想を大幅に下回る見込みです。

以上のことから当社は、通期の業績予想を修正することといたしました。

なお、当期末の配当予想につきましては、平成30年5月10日に公表いたしました内容（1株につき16円）から修正はございません。

詳細につきましては、本日（平成31年2月7日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	6,182,267	6,787,630
受取手形及び売掛金	8,014,756	8,528,155
電子記録債権	151,182	77,706
商品及び製品	1,631,033	1,520,667
仕掛品	5,412,367	7,046,364
原材料及び貯蔵品	846,325	666,110
その他	820,390	1,548,600
貸倒引当金	△565	△1,907
流動資産合計	23,057,759	26,173,328
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	14,282,632	14,125,459
減価償却累計額	△10,032,897	△10,144,369
建物及び構築物 (純額)	4,249,734	3,981,090
機械装置及び運搬具	9,826,729	10,417,020
減価償却累計額	△7,570,389	△7,969,968
機械装置及び運搬具 (純額)	2,256,339	2,447,052
土地	4,371,944	4,370,506
リース資産	13,453	17,637
減価償却累計額	△9,925	△15,456
リース資産 (純額)	3,528	2,180
建設仮勘定	158,344	560,214
その他	3,110,244	3,434,202
減価償却累計額	△2,570,055	△2,876,623
その他 (純額)	540,188	557,578
有形固定資産合計	11,580,080	11,918,623
無形固定資産	654,358	685,663
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	161,818	197,870
その他	4,388,735	3,913,379
貸倒引当金	-	△367
投資その他の資産	4,550,553	4,110,881
固定資産合計	16,784,992	16,715,168
資産合計	39,842,752	42,888,497

(単位：千円)

	前連結会計年度 (平成30年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	3,943,838	2,165,176
電子記録債務	542,976	1,062,338
短期借入金	1,800,000	5,400,000
1年内返済予定の長期借入金	818,750	625,000
未払法人税等	823,968	233,376
製品保証引当金	127,117	126,227
賞与引当金	486,324	325,466
役員賞与引当金	48,818	5,550
その他	2,279,649	1,606,767
流動負債合計	10,871,444	11,549,903
固定負債		
長期借入金	806,875	3,555,625
退職給付に係る負債	257,898	665,706
その他	1,382	1,382
固定負債合計	1,066,156	4,222,714
負債合計	11,937,600	15,772,618
純資産の部		
株主資本		
資本金	8,932,627	8,932,627
資本剰余金	462,236	462,236
利益剰余金	16,238,399	16,379,019
自己株式	△11,082	△11,256
株主資本合計	25,622,180	25,762,627
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	2,017,480	1,190,466
為替換算調整勘定	153,109	△47,177
退職給付に係る調整累計額	112,381	100,131
その他の包括利益累計額合計	2,282,970	1,243,419
非支配株主持分	—	109,832
純資産合計	27,905,151	27,115,879
負債純資産合計	39,842,752	42,888,497

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
(四半期連結損益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
売上高	22,678,130	21,341,525
売上原価	14,994,573	16,147,835
売上総利益	7,683,557	5,193,689
販売費及び一般管理費	4,452,867	4,586,899
営業利益	3,230,690	606,790
営業外収益		
受取利息	14,977	8,379
受取配当金	32,616	38,606
雑収入	84,426	108,906
営業外収益合計	132,020	155,893
営業外費用		
支払利息	21,826	23,575
為替差損	142,627	99,221
雑損失	7,841	33,615
営業外費用合計	172,295	156,412
経常利益	3,190,414	606,271
特別利益		
固定資産売却益	663	14,853
関係会社清算益	378	-
特別利益合計	1,042	14,853
特別損失		
固定資産除却損	4,023	9,217
ゴルフ会員権評価損	3,075	-
その他	2,729	131
特別損失合計	9,828	9,349
税金等調整前四半期純利益	3,181,627	611,775
法人税等	956,501	73,580
四半期純利益	2,225,126	538,195
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	20,942	△2,578
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,204,184	540,773

(四半期連結包括利益計算書)
(第3四半期連結累計期間)

(単位：千円)

	前第3四半期連結累計期間 (自平成29年4月1日 至平成29年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自平成30年4月1日 至平成30年12月31日)
四半期純利益	2,225,126	538,195
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	401,378	△827,014
為替換算調整勘定	451,614	△200,255
退職給付に係る調整額	△18,855	△12,250
その他の包括利益合計	834,138	△1,039,519
四半期包括利益	3,059,265	△501,324
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	3,014,808	△498,777
非支配株主に係る四半期包括利益	44,456	△2,546

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)

当第3四半期連結会計期間において、東和半導体設備(南通)有限公司を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。なお、東和半導体設備(南通)有限公司は当社の特定子会社に該当しております。

また、特定子会社の異動には該当していませんが、第2四半期連結会計期間において、TOWAレーザーフロント株式会社(旧社名:オムロンレーザーフロント株式会社)の株式を取得したため、連結の範囲に含めております。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。